

Plaskon CMU-880-MA

Епоху; Epoxide

Cookson Electronics - Semiconductor Products

Описание материалов:

This material is an epoxy Molded Underfill compound developed for transfer mold equipment to underfill, and overmold if needed, Flip Chip in Package (FC-BGA and FC-CSP) in one step. It offers high productivity with an automated, simple, robust and fast process compared to liquid encapsulation. Higher reliability is demonstrated with the material's higher Tg, lower CTE, no particle segregation or settling and longer outlife compared to liquid encapsulants. PLASKON? CMU Series is the total molded underfill solution for Flip Chip in Package.

Главная Информация

Характеристики	Полупроводникового Низкий уровень защиты Обрабатываемость, хорошая
Формы	Жидкость
Метод обработки	Литье из смолы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.00	g/cm ³	ASTM D792

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль			ASTM D790
22°C	2.45	MPa	ASTM D790
260°C	0.0686	MPa	ASTM D790
Flexural Strength			ASTM D790
22°C	0.0132	MPa	ASTM D790
260°C	0.00127	MPa	ASTM D790

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	135	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	9.0E-6	cm/cm/°C	ASTM D696
Теплопроводность	0.70	W/m/K	ASTM C177

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость (3.18 mm)	V-0	UL 94

Дополнительная информация

Recommended Storage Temperature: 5°C Life @ 5°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 24 months Life @ 21°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 5 days Life @ 35°C, defined as not more than 40% loss of spiral flow based on original values.: 2 days Spiral Flow, 175°C, 1000 psi: 160 cm Shimadzu Viscosity, 175°C, 1000 psi: 30 poise Ram Follower Gel Time, 175°C, 1000 psi: 25 sec Ash Content: 87.5 % Hydrolyzable Halides: <1 ppm Moisture Absorption, 85°C/85%RH, 168 hrs: 0.25% Filler Size, Max in traces: 40 µm Filler Size, average: 6 µm Cull Hot Hardness, Shore D: 65 All test specimens are transfer molded and post cured for 4 hours at 175°C
Linear Thermal Expansion, Alpha 1: 9 cm⁻⁶/cm/°C
Linear Thermal Expansion, Alpha 2: 40 cm⁻⁶/cm/°C

Инструкции по впрыску

Resin Transfer Molding:

Molding Temperature: 165 to 185°C

Molding Pressure: 1000 psi

In Mold Cure Time: 50 to 100 sec

Post Mold Cure Time, 175°C: 0 to 2 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat